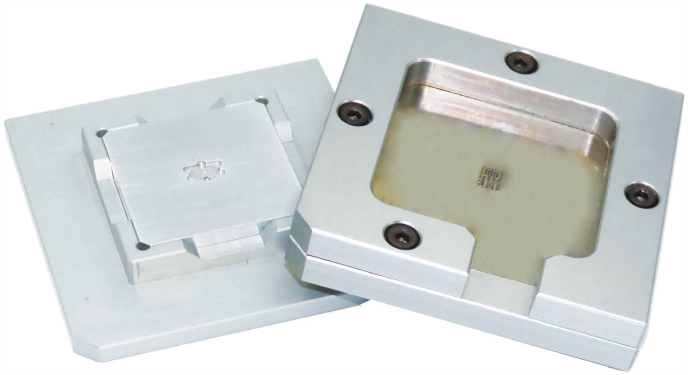
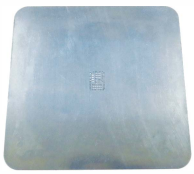
## BGA 零件植球治具



### 特　點

- BGA 植球治具為鋁合金材質。
- 依據 BGA 元件不同尺寸及錫球矩陣排列方式製作。
- 可更換式模組疊立架構，操作簡單易學。達到零誤差。
- BGA 元件上塗佈錫膏作業，經由 974 IR 非接觸式迴焊爐 Profilef 曲線加熱技術進行植球，良率 100%。

**BGA-MBC**
**BGA 零件植球鋼片**

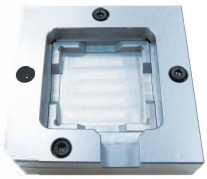


( 可依客戶零件尺寸訂製 )

**另選購**

974 IR 熱輻射迴焊植球機

**BGA-MBD**
**BGA 零件植球治具母座**



**BGA-MBE**
**BGA 載具板**

( 可依客戶零件尺寸訂製 )

## alpha 無鉛錫膏

### 特　點

- 適用於 SMT 製程，焊後殘留具有相當高的絕緣阻抗，不必清洗。
- 錫粉合金組合成份：Sn96.5% ˙Ag3.0% ˙Cu0.5%。
- 熔點：約 217°C ~219°C
- 金屬含量：85.0%
- 助焊劑含量：15.0%
- 焊接方式：紅外線熔焊、熱風式熔焊、預熱鐵板式熔焊。
- 未開封的錫膏，必須儲存於冷藏櫃。
- 自冷藏櫃取出，在室溫下回溫 2 小時以上，才可開封使用。
- 儲存條件 0~10°C冷藏。產品有效期為 3 個月。

## 207 BGA 無鉛助焊膏

### 特　點

- 在焊接的合金材料和被焊物的金屬介面，金屬之間的結合共晶現像，及焊點的潤濕性，將影響合金的形成。
- 助焊膏中所添加少量的活性劑，是極為關鍵降低被焊物的表面張力。能確保錫球在被焊物間的銅箔點擴散。
- 活性佳的助焊膏，可去除被焊物表面的氧化物。
- 不含鹵素、松香類油性膏狀助焊膏，不揮發高固態狀，黏度適中。錫球熔錫擴散所需介面活化功能。
- BGA 元件在高溫迴焊過程下，保證助焊劑活化、錫球熔錫、塌陷、金屬共晶焊點成型的潤濕性。